

产品性能

改性酚醛树脂

Modified Phenolic Resin



产品数据

Name	软化点℃ (DSC)	固化温度 (℃)	玻璃化转变温度℃ (DMA)	5%分解温度 (℃)	参考 用途
CMIC-001	>120	200-315	>350	>400	可用于 砂轮
CMIC-PEN 001	>150	250-375	>450	>520	陶瓷和 纤维

耐高温，粘接力强；

High temperature resistant,

适合“重负荷，强力磨”超硬树脂结合剂砂轮；适合高温工况的陶

瓷和纤维类制品；

suitable for "heavy load, power grinding" resin bond Diamond or CBN grinding wheel ; high temperature working ceramics, Fibre etc

单组份环氧树脂

Epoxy Adhesive

Chemical name	Ratio of constituents
Epoxy Resin	55%
Calcium carbonate	39.30%
Dicyandiamide	5.10%

明星产品，出口欧、美、日等

Warmly welcomed and Widely used in EU, USA and Japan etc

适合涂附磨具，特别是百叶片，千叶轮和弹性磨盘

Suiting for coated abrasives, such as Flap disc etc

最好修掉包装外部的部分

